

RJ45M R1D 3.3E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 jeladó-aljzatok (mágneses) gigabitos alkalmazásokhoz (1000 base-T) integrált kompenzációval - aktívan együttműködik az induktív és kapacitív csatlakozásokkal, valamint helyet takarít meg a NYÁK-on.

A termékválaszték a következő kiviteli változatokat tartalmazza:

- 90°, fekvő (vízszintes) és 180°, álló (függőleges)
- felfelé reteszelő / lefelé reteszelő
- THT, THR vagy SMD forrasztási eljárások
- Különböző kiviteli változatok széles választéka, beépített LED-ekkel és az árnyékolás érintkező füleivel
- Átviteli sebesség 1 Gbit/s-ig
- Tálcán (TY) vagy tekercsen (feltekercselt szalag, RL)
- Kompatibilis a moduláris RJ45 csatlakozóval, az ANSI / TIA-1096-A és IEC 60603 szabványnak megfelelően.
- Átütési szilárdság ≥ 1500 V AC RMS (2250 V AC csúcsérték) az IEEE 802.3 szerint
- Átütési szilárdság ≥ 1500 V AC (csúcsérték) vagy ≥ 1500 V DC az IEC 60603 szerint
- Megfelelés az IEEE 802.3 követelményeinek (1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab vagy 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)

Tulajdonságok és előnyök:

- Bővített, -40 °C és $+85$ °C közti hőmérséklet-tartomány a maximális teljesítmény érdekében

- Megerősített aranyréteg ($30 \mu\text{m}$) a megnövelt korrózió elleni védelem érdekében
- A legalább 0,3mm-es kiemelkedés tökéletes forrasztást eredményez.

Általános rendelési adatok

Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, RJ45 jacks transformer, 10/100 MBit/s, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 90°. Retesz opció: bottom, Shield tabs: 6 tabs, 30...80 μm Ni / $\geq 30 \mu\text{m}$ Au, LED: Igen, zöld, sárga, Pólusszám: 8, Tape
Rendelési szám	2564410000
Típus	RJ45M R1D 3.3E4G/Y RL
GTIN (EAN)	4050118572902
Qty.	200 Stück
Csomagolás	Tape

RJ45M R1D 3.3E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	21,35 mm	Mélység (coll)	0,841 inch
Magasság	16,8 mm	Magasság (coll)	0,661 inch
Legalacsonyabb változat magassága	13,5 mm	Szélesség	15,9 mm
Szélesség (coll)	0,626 inch	Nettó tömeg	0,001 g

Electrical properties

Névleges feszültség	125 V	Névleges áram	1,5 A
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	1500 V DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1000 V DC

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 9T	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	II
Küszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező alapanyaga	Foszfor-bronz
Érintkező anyaga	Cu-ötvezet	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C		

Csomagolás

Csomagolás	Tape	VPE hosszúság	345 mm
VPE szélesség	345 mm	VPE magasság	125 mm
Dobos tekercs átmérője Ø (A)	330 mm	Felületi ellenállás	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$

Rendszerspecifikációk

Colour of left LED	zöld	Colour of right LED	sárga
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	750
Felszerelés NYÁK-ra	THT/THR-forrasztott csatlakozással	Feszültség, max.	2,6 V
Feszültség, min.	1,8 V	Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás, Hullámforrasztás
Forrasztótüske hossza (l)	3,3 mm	Forrasztótüske méretei	Nyolcszögletű
Forrasztótüskék száma pólusonként	1	Kimenő könyök	90°
LED	Igen	Osztás, inch (P)	0,05 "
Osztás, mm (P)	1,27 mm	Pólusszám	8
Retesz opció	bottom	Shield tabs	6 tabs
Teljesítménykategória	10/100 MBit/s	Termékcsalád	OMNIMATE Data - RJ45 átalakító dugasz
Tolerance of solder pin position	± 0.1 mm	Védelmi osztály	IP20
Áram	20 mA	Árnyékolás	Igen
Árnyékolás felülete	nikkelezett	Árnyékoló anyag	Sárgaréz
Átviteli sebesség	10/100 MBit/s		

RJ45M R1D 3.3E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9,1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Certificate of Compliance
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

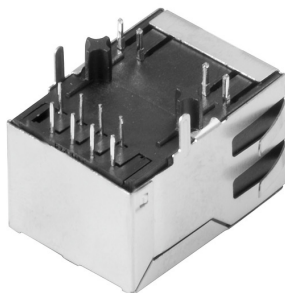
RJ45M R1D 3.3E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

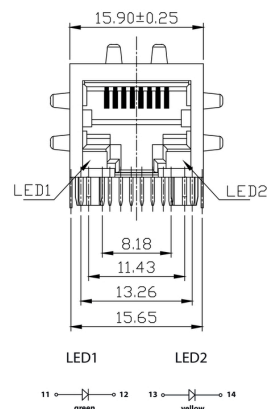
www.weidmueller.com

Rajzok

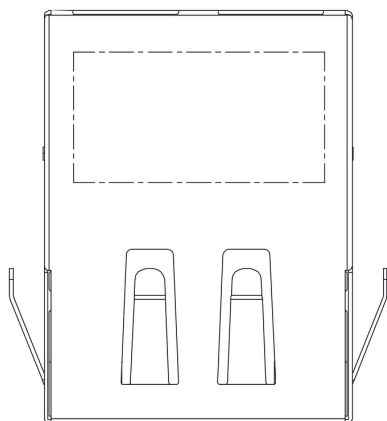
Méretrajz



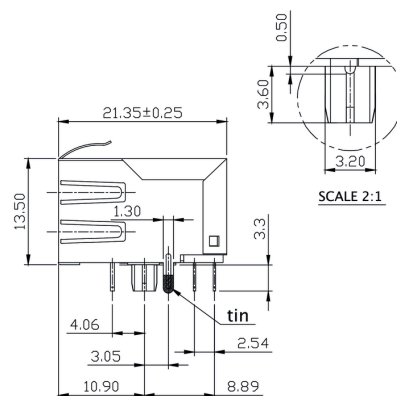
Méretrajz



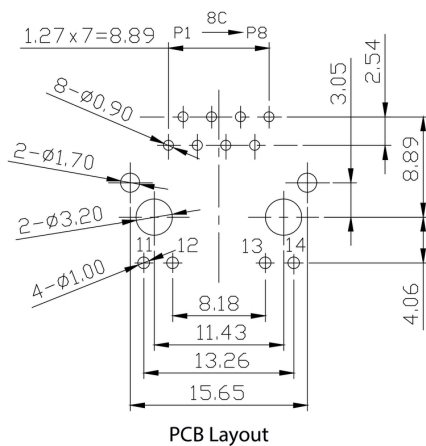
Méretrajz



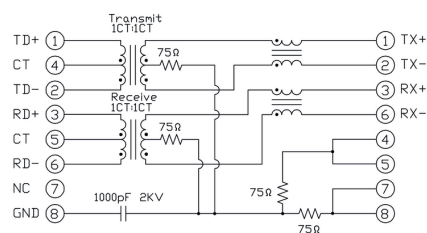
Méretrajz



NYÁK kivitel



Kapcsolási rajz



RJ45M R1D 3.3E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
										Packaging
										TY
										RL
										Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)
										LED
										Y/G
										Green/Yellow (standard)
										G/Y
										Green/Yellow/Green-Yellow
										O/G
										Orange/Green
										R/O
										Red/Orange
										...
										(further combinations possible)
										N
										without LED
										Contact surface thickness
										4
										1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
										EMI tabs (ground fingers)
										E
										E = with EMI tabs
										N
										N = without EMI tabs
										Solder Pin length
										3.2
										3.2 mm
										1.6
										1.6 mm
										D
										SMD
										Direction, latch style
										U
										Horizontal (90°, side entry), latch up
										D
										Horizontal (90°, side entry), latch down
										V
										Vertical (180°, top entry)
										Y
										Diagonal (45°), latch up
										Number of Ports
										1
										1 Port
										12; 14; ...
										multi ports side by side, Multiport
										21; 41; ...
										multi ports about each other, Multilevel
										Assembly on PCB
										R
										Through Hole Reflow - THR
										Soldering process: Wave or Reflow soldering
										S
										Surface Mount Technology - SMT
										Soldering process: Reflow soldering
										T
										Through Hole Technology - THT
										Soldering process: Wave
										Performance Category
										C5
										Category 5
										C6
										Category 6
										C6A
										Category 6A
										C5e
										Category 5e
										M
										10/100 Mbit
										G1
										10/100/1000 Mbit
										G10
										10 Gbit
										U
										Unshielded
										MP
										10/100 Mbit with POE
										MP+
										10/100 Mbit with POE+

Type codes

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.